

邀请函

尊敬的_____，您好：

2025年，3GPP将正式启动6G研究项目，而当前（2024年）正处于6G技术遴选的关键窗口期。智能超表面技术（RIS），作为6G的潜在关键技术之一，利用可编程的人工超材料，能够构建智能电磁波传播环境，为未来移动通信网络提供了全新范式。该技术于2024年6月荣登夏季达沃斯论坛“十大新兴技术”榜单。为进一步推动RIS技术的标准化及其产业化落地，将于2024年11月9日9:00-18:30在西安高新国际会议中心举办主题为“新视界，RIS赋能6G”的

第三届智能超表面（RIS）技术论坛。

本次论坛是智能超表面技术联盟主办，中兴通讯、中国移动、中国电信、中国联通、东南大学、西安电子科技大学、中国通信学会和中国电子学会通信分会联合承办。

现诚邀您莅临本次论坛，共同探讨RIS技术标准化及产业化落地！



(2024年) 第三届智能超表面技术论坛

(参会回执)

参会代表 姓名	性别	工作单位及职务 (在校 学生请填写学校)	Email & Mobile	是否用午餐
			Email: Mobile:	

参会回执反馈邮箱: secretariat@risalliance.com

会议联系人: 王老师 18503066433

